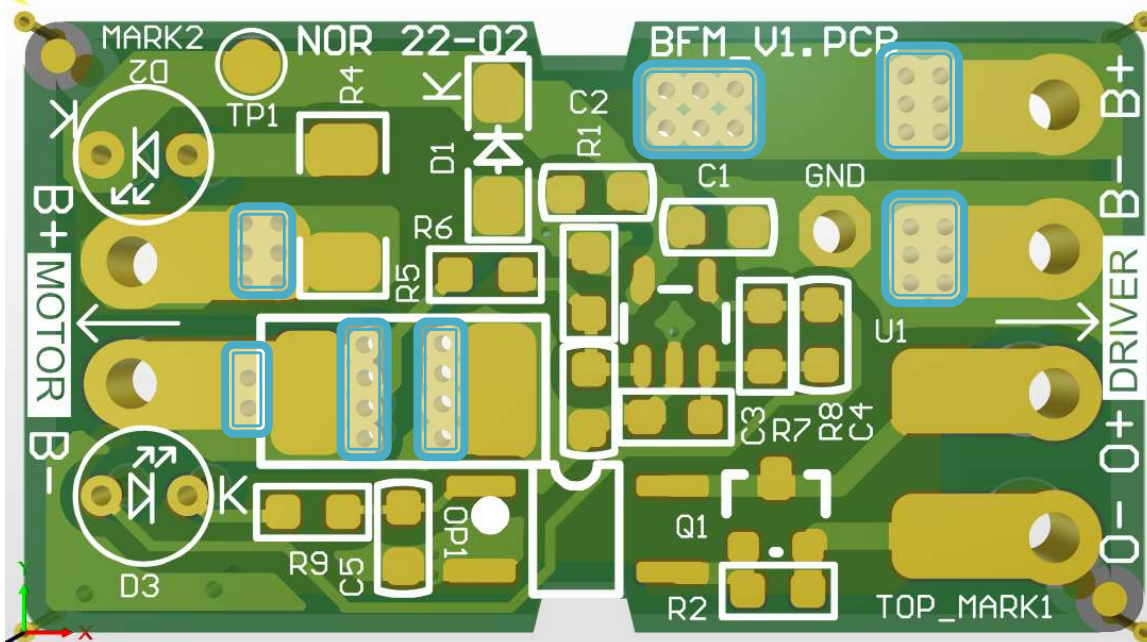
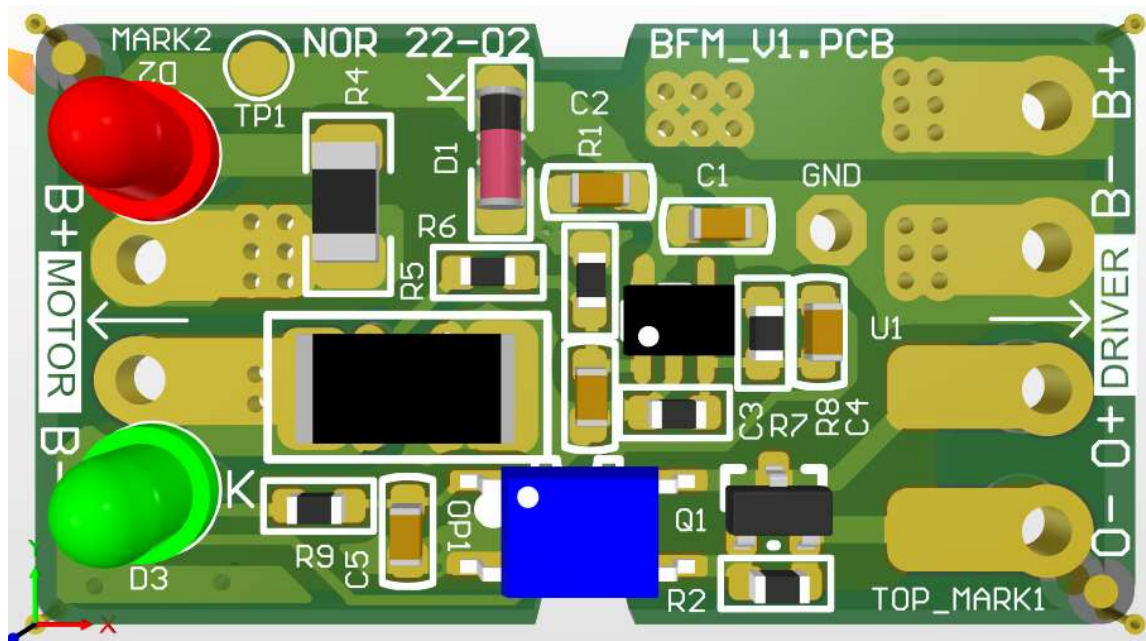


PCB 焊接	产品名称	产品型号	工序	文件编号	版本	页数	制订时间
工艺要求	抱闸监测模块	BFM_V1	焊接	QM033220220309	V1	1/1	20220309

1. BFM_V1 加锡位置  蓝色双线框内半透明覆盖的 PAD 区，要求每个通孔内上下焊锡通透（灌满焊锡）
顶层



2. 下图的 D2 红色和 D3 绿色插件 LED 指示灯，先裁剪管脚长度为 1.6~2mm，再焊接，要求焊后管脚与底板面平齐



3. 表贴焊接导线， B+：红色引线， B-：黑色引线， 0+：蓝色引线， 0-：白色引线

- 1) 测试点，不接受沾锡
- 2) 所有极性元件（注：其中二极管的负极都有字符“K”），严禁方向反；
- 3) 不接受虚焊，空焊，焊锡短路；
- 4) 未特殊说明的元件，均紧贴线路板焊接；
- 5) 手工操作要做防静电处理；
- 6) 未特殊说明的参见《IPC-A-610E 电子组件的可接受性》标准；
贴装元件位置图详见焊接丝印图文件

编制		审核		批准	
日期		日期		日期	